

Wir suchen in Dresden zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Operator (w/m/div)

Ihre Aufgaben:

Sie steuern Anlagen und führen Bearbeitungsprozesse in der Waferfertigung und Chipmontage durch:

- Lithographie
- Messtechnik
- Bedampfungs- und Sputteranlagen
- Ätzanlagen
- Wafer sägen
- Chip- und Drahtbonden
- Verkappen, Lecktest
- Elektrische Endmessung
- Prozesskontrolle, Mikroskopie

Was Sie mitbringen:

- Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Mikrotechnologie oder vergleichbare technische Ausbildung
- Erfahrung mit der Arbeit in Reinräumen (Schutzkleidung, Gelblicht) von Vorteil
- Bereitschaft zur Schichtarbeit (2/3 Schicht, ggf. rollierende Schicht)
- Eigenständige Arbeit an mehreren Prozessen
- Sorgfalt und hohe Leistungsbereitschaft
- Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Was wir bieten:

- Unbefristete Festanstellung in Vollzeit (Teilzeit nach Absprache)
- Vielseitiges Tätigkeitsfeld mit Gestaltungsspielraum
- Entwicklungsmöglichkeiten
- Aufgeschlossenes, innovatives Team
- Flache Hierarchien
- Optimale Verkehrsanbindung
- Überdurchschnittlicher Urlaubsanspruch
- Attraktive Zusatzleistungen, z. B.: Fahrtkostenzuschuss, Kindergartenzuschuss

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an:

Steffen Zietzschmann
SAW COMPONENTS Dresden GmbH
Manfred-von-Ardenne-Ring 7
01099 Dresden
zietzschmann@sawcomponents.de
0351 88725-10
www.sawcomponents.de